

HEAT SINK COMPOUND

Pasta termoprzewodząca ułatwiająca odprowadzanie ciepła.

1. OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Mieszanka zwiększająca przewodność cieplną i skuteczne odprowadzanie ciepła z elementów elektronicznych.

2. WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka przewodność cieplna.
- Doskonałe buforowanie wilgoci.
- Niska zawartość zanieczyszczeń metalicznych.

3. ZASTOSOWANIA

- Płytki drukowane.
- Podzespoły elektroniczne.
- Podzespoły sterownicze.

4. WSKAZÓWKI

- Nakładać na czystą i suchą powierzchnię.
- Nie mieszać z innymi produktami.
- Nie stosować na urządzeniach znajdujących się pod napięciem.

Karta charakterystyki (SDS) zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1907/2006 art. 31 (z późniejszymi zmianami) jest dostępna dla wszystkich produktów.

5. Dane techniczne produktu

Wygląd:	Pasta.
Kolor:	Biały.
Zapach:	Charakterystyczny:
Gęstość	w temp. 20°C: 2,3 g /cm ³
Temperatura pracy:	od -50°C do 300°C

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 2/2

HEAT SINK COMPOUND

6. Opakowanie

Tubka: 20G
100G

Wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszej publikacji bazują na doświadczeniu serwisowym i/lub testach laboratoryjnych. Ze względu na dużą różnorodność sprzętu i warunków, a także nieprzewidywalne czynniki ludzkie, zalecamy testowanie naszych produktów przed użyciem w warunkach faktycznego stosowania. Wszystkie informacje zostały udostępnione w dobrej wierze, ale nie ma mowy o jakiegokolwiek gwarancji wyrażonej lub domniemanej.

Niniejsza karta techniczna może podlegać korektom ze względów legislacyjnych, dostępności elementów i nowo uzyskanych doświadczeń. Ostatnia i wyłącznie aktualna wersja niniejszej karty technicznej zostanie wysłana do Państwa na życzenie lub można znaleźć ją na naszej stronie internetowej: www.crcind.com.

Zalecamy Państwu zarejestrowanie swojego produktu na tej stronie internetowej, aby w przyszłości uzyskiwać automatycznie wszystkie zaktualizowane wersje.

Wersja: 4.1

Data: 6 listopada 2021 r.

